

# AOYAMA & PARTNERS

REGISTERED PATENT ATTORNEYS



O. Kawamiya  
Y. Tamura  
M. Tanaka  
H. Yamazaki  
Y. Shibata  
.....  
T. Higashima  
T. Aoyama  
Y. Furukawa  
M. Iwasaki, Ph.D.  
T. Higuchi  
.....

A. Itoh  
H. Ishii  
M. Yamamoto  
M. Wada  
M. Samejima  
M. Ishino  
A. Maeda  
T. Yamada  
M. Yano  
Y. Kitahara  
T. Nakajima  
M. Matsutani  
Y. Ohata  
.....

f. Omeri  
S. Nakajima  
K. Kujima  
Y. Tsuboi  
T. Ueda, Ph.D.  
H. Seki, Ph.D.  
K. Tashiro  
M. Takeuchi  
T. Motoyama, Ph.D.  
M. Saito  
H. Kano  
S. Genba  
Y. Maehori  
K. Morizumi  
C. Saito  
H. Nakano  
K. Inaba  
M. Nakatsuka  
H. Tamura  
Y. Nakakura  
S. Nishishita  
K. Tomita, Ph.D.  
H. Okazaki  
J. Kawabata  
H. Shinagawa, Ph.D.  
.....

H. Goto  
I. Shiga  
H. Okabe  
T. Yoshida  
H. Ema  
S. Saito  
H. Terada  
M. Ozawa  
K. Genjou  
M. Ohtsuka  
M. Fukumasa, Ph.D.  
J. Morikawa  
M. Nitta  
Y. Sakurai  
.....  
E. Kaizaki  
M. Taniguchi

The International Bureau of WIPO  
34, Chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20,  
Switzerland

## Head Office:

IMP Building, 1-3-7, Shiromi, Chuo-ku  
Osaka, 540-0001 JAPAN

Mail : Osaka Central F.O. Box 16, 530-8691 JAPAN

E-Mail: info@aoyamapat.gr.jp

Phone: (81)6-6949-1261

Fax : (81)6-6949-0361(G3)/(81)6-6949-0362(G4)

September 20, 2005

**VIA FACSIMILE & DHL**  
**(Sheet 1 of 3)**

## Amendment of the claims under Article 19(1) (Rule 46)

International Application No. PCT/JP2005/007412

International Filing Date: April 18, 2005

Applicant: Name : MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.  
Address: 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan

Agent Name : HIGASHIMA, Takaharu  
Address: AOYAMA & PARTNERS,  
IMP Building, 3-7, Shiromi 1-chome, Chuo-ku,  
Osaka-shi, Osaka 540-0001 Japan

Agent's file reference: P037786-P0

Dear Sirs:

The applicant, who received the International Search Report which is related to the above-identified International Application and which was transmitted on 26.7.2005, hereby files an Amendment under Article 19(1) as in the attached sheets.

Claim 1 is amended by incorporating the feature of claim 2.  
Claim 2 is cancelled.

The applicant further files as attached hereto a Brief Statement.

We would appreciate it if you would acknowledge receipt of this letter by return facsimile.

Sincerely yours,  
AOYAMA & PARTNERS

Takaharu HIGASHIMA

TH/RT/fk  
Encls.

1. Amendment under Article 19(1)	1 copy
2. Brief Statement	1 copy

## 請求の範囲

〔1〕 （補正後） 電気信号端子を備え、前記電気信号端子に外部から与えられる電気信号によって駆動され発光する発光素子と、

前記電気信号を出力して前記電気信号端子に印加する発光素子駆動用回路、及び外部と電氣的に接続するための保護端子に接続された保護回路を、半導体を用いて形成した発光素子駆動用半導体チップと、

を有し、

前記発光素子は、絶縁膜を介して前記発光素子駆動用半導体チップ上に配置され、前記絶縁膜を貫通する接続体によって前記発光素子駆動用半導体チップに接続され、

前記発光素子及び前記発光素子駆動用回路のそれぞれは、前記保護端子を通して外部と接続されることを特徴とする発光装置。

〔2〕 （削除）

〔3〕 前記保護回路が、前記発光素子駆動用半導体チップの発光素子駆動用回路を形成する素子と同一の製法によって形成された一若しくは複数個の素子を備えたことを特徴とする請求項2に記載の発光装置。

〔4〕 前記発光素子駆動用半導体チップの面上に、それぞれ別個のチップで構成された複数個の前記発光素子が装着されており、

前記発光素子駆動用半導体チップが、前記発光素子を相互に接続する導電経路を設けたことを特徴とする請求項1に記載の発光装置。

〔5〕 前記発光素子駆動用半導体チップにおいて、前記導電経路が、前記発光素子駆動用回路を形成する拡散層又は金属配線層と同一処理方法によって形成された拡散層又は金属配線層によって形成されたことを特徴とする請求項4に記載の発光装置。

〔6〕 前記導電経路が、所定の値を有する抵抗を備えたことを特徴とする請求項4に記載の発光装置。

## 条約第19条(1)に基づく説明書

請求の範囲第1項は、出願時の第2項に含まれていた内容の、発光素子駆動用半導体チップが保護回路を含むこと、を追加すると共に、発光素子と発光素子駆動用半導体チップとの接続関係が明確になるように、補正した。

請求の範囲第2項は、削除した。

## Amendment under Article 19(1)

1. (Amended) A light emitting device comprising:

5 a light emitting element having an electric signal terminal, which is driven to emit light by an electric signal given to the electric signal terminal from outside; and

10 a semiconductor chip for driving the light emitting element, having a light emitting element drive circuit and a protective circuit that are made of semiconductors, the light emitting element drive circuit outputting and applying the electric signal to the electric signal terminal, the protective circuit being connected to a protective terminal for electrically connecting to the  
15 outside,

wherein the light emitting element is mounted on the semiconductor chip for driving the light emitting element through a insulating film and is connected to the semiconductor chip for driving the light emitting element  
20 by a connection matter penetrating the insulating film,

the light emitting element and the semiconductor chip for driving the light emitting element are connected to the outside through the protective terminal, respectively.

2. (Cancelled)

3-15. (Original)